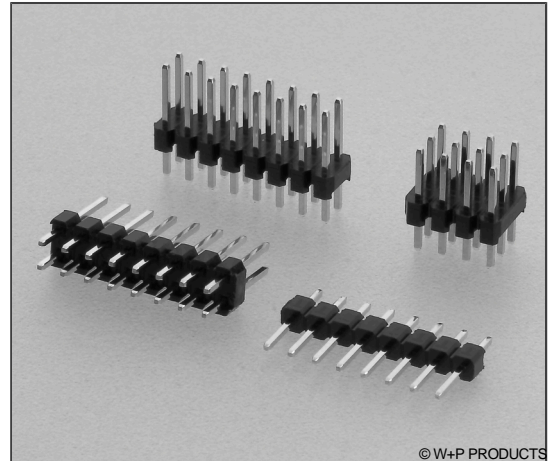


# 943 / 944 / 945

Stiftleisten RM 2,54mm, gerade, 1-/2-/3-reihig  
Pin Headers, 2.54mm Pitch, Straight, 1/2/3 Rows

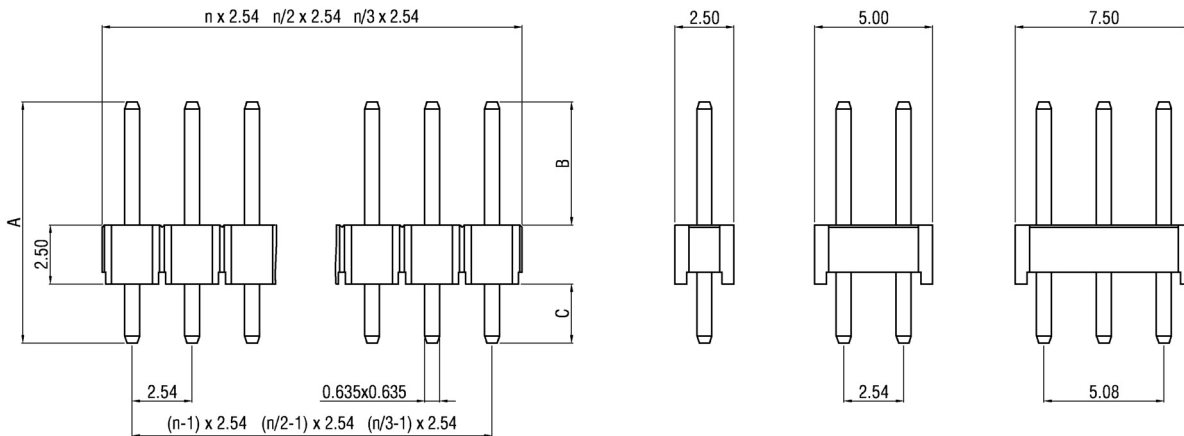
## Technische Daten / Technical Data

Isolierkörper <i>Insulator</i>	Thermoplast, nach UL94 V-0 <i>Thermoplastic, rated UL94 V-0</i>
Kontaktmaterial <i>Contact Material</i>	Vierkantstift 0,635mm, Kupferlegierung <i>0.635mm square pin, copper alloy</i>
Kontaktoberfläche <i>Contact Surface</i>	Lt. Oberflächenoptionen, über Ni <i>Acc. to options (see below), over Ni</i>
Durchgangswiderstand <i>Contact Resistance</i>	< 20 mΩ
Isolationswiderstand <i>Insulation Resistance</i>	> 1000 MΩ
Spannungsfestigkeit <i>Test Voltage</i>	1 kV DC
Nennspannung <i>Voltage Rating</i>	250 V AC
Nennstrom <i>Current Rating</i>	3 A
Temperaturbereich <i>Temperature Range</i>	-40 °C ... +125 °C
Verarbeitung <i>Processing</i>	Wellen- oder Reflow-Lötverfahren <i>Wave or reflow soldering</i>



© W+P PRODUCTS

Passende Buchsenleisten:  
*Compatible Female Headers:*  
**153 154 157 159 160/162 349 624** etc.  
Weitere siehe Kapitel B  
*Please see ch. B for more*



PCB Layouts und Detailzeichnungen s. tech. Informationen / Seite A12  
*Please note tech. information / page A12 for PCB layouts and detailed drawings.*

Series*	Dimensions*	Contacts*	Plating*
<b>944</b>	<b>10</b>	<b>010</b>	<b>00</b>
Gestanzte/geprägte Kontakte <i>Stamped/formed contacts</i>	10 A=10,20 B=5,20 C=2,50mm	001-050 Einreihig <i>Single row</i>	00 Au flash
943 Einreihig <i>Single row</i>	11 A=10,80 B=5,80 C=2,50mm	004-100 Zweireihig <i>Double row</i>	110 Sel. Au 0,25µm / Au flash
944 Zweireihig <i>Double row</i>	12 A=11,30 B=5,50 C=3,30mm	009-120 Dreireihig <i>Triple row</i>	130 Sel. Au 0,75µm / Au flash
945 Dreireihig <i>Triple row</i>	13 A=12,60 B=6,80 C=3,30mm		50 Sn
	14 A=13,90 B=8,10 C=3,30mm		66 Sel. Au flash / Sn
	15 A=14,70 B=8,90 C=3,30mm		610 Sel. Au 0,25µm / Sn
	16 A=17,70 B=11,90 C=3,30mm		80 Sel. Au 0,75µm / Sn
	17 A=19,80 B=14,00 C=3,30mm		Au flash <= 0,1µm
	18 A=21,60 B=15,80 C=3,30mm		Au flash <= 0,1µm
	19 A=22,80 B=17,00 C=3,30mm		
	20 A=24,90 B=19,10 C=3,30mm		
	A/B/C Gesamtlänge & Wunschmaße <i>Total length &amp; Dimensions</i>		

Wir fertigen die Stiftleisten in jeder gewünschten Polzahl.  
Raster 5,08mm, 7,62mm, etc. oder Sonderraster sowie  
weitere Stiftlängen und Abmessungen auf Anfrage.  
Bestellseite "Sonderbestückungen bei Stiftleisten" unter  
Techn. Informationen.

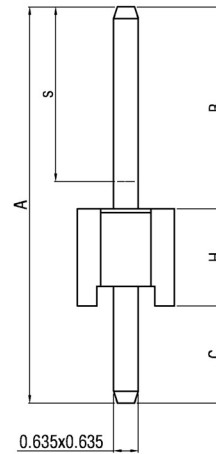
*We will manufacture the pin headers in every desired number of contacts. 5.08mm, 7.62mm, etc. and varying pitches as well as more dimensions on request. Order page "Customer-specific Pin Configurations" in Technical Information.*

\* Dies ist ein Bestellbeispiel - bitte durch Ihre Spezifikationen ersetzen.  
\* This is an order example - please replace by your specifications.

## Gerade Stiftleisten

- A : Gesamtstiftlänge
- B : Länge Steckseite
- C : Länge Lötseite
- H : Höhe Isolierkörper
- s : Bereich der sel. Veredelung

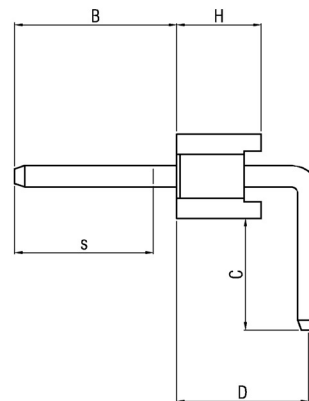
Messpunkt für **s** bei 2-4mm von der Stiftspitze.



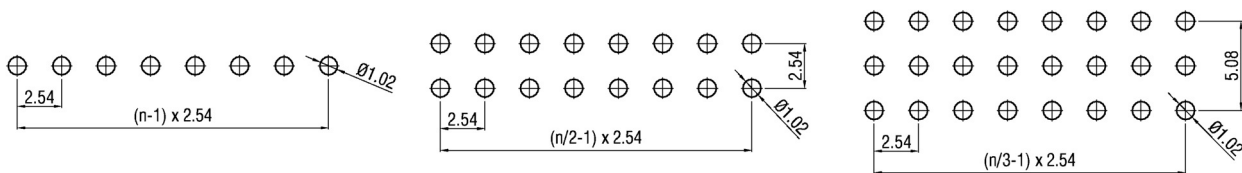
## Gewinkelte Stiftleisten

- B : Länge Steckseite
- C : Länge Lötseite
- D : Abstand zu Steckseite
- H : Höhe Isolierkörper
- s : Bereich der sel. Veredelung

Messpunkt für **s** bei 2-4mm von der Stiftspitze.



## PCB Layouts



### Reflow-Lötempfehlung für kurze Lötzeiten

Die Bauteile sollten gemäß folgendem Temperatur-Profil in Anlehnung an die IPC/JEDEC J-STD-020C für bleifreies Löten im Reflow-Verfahren verarbeitet werden (Maximalwerte).

Profileigenschaft	Kennwert
Temperatur Minimum $T_{Smin}$	150 °C
Temperatur Maximum $T_{Smax}$	200 °C
Dauer $T_{Smin} - T_{Smax}$	60 – 180s
Temperatur Lötbereich $T_L$	217 °C
Verweildauer oberhalb $T_L$	60 – 180s
Ramp-Up Rate $T_{Smax} - T_P$	max. 3 °C / s
Höchsttemperatur $T_P$	260±5 °C
Dauer Höchsttemperatur	20 – 40s
Ramp-Down Rate $T_{Pmax} - T_{Smin}$	6 °C / s
Dauer 25 °C – Höchsttemperatur $T_P$	max. 8m

### Reflow Soldering Recommendation For Shorter Peak Times

Items should be soldered according to IPC/JEDEC J-STD-020C temperature profile for leadfree reflow soldering (maximum values).

Profile Feature	Key Values
Minimum Temperature $T_{Smin}$	150 °C
Maximum Temperatur $T_{Smax}$	200 °C
Duration $T_{Smin} - T_{Smax}$	60 – 180s
Soldering Range Temperature $T_L$	217 °C
Duration above $T_L$	60 – 180s
Ramp-Up Rate $T_{Smax} - T_P$	max. 3 °C / s
Peak Temperature $T_P$	260±5 °C
Duration Peak Temperature	20 – 40s
Ramp-Down Rate $T_{Pmax} - T_{Smin}$	6 °C / s
Duration 25°C - Peak Temp. $T_P$	max. 8min



# Informationen zum Wellen-Lötverfahren

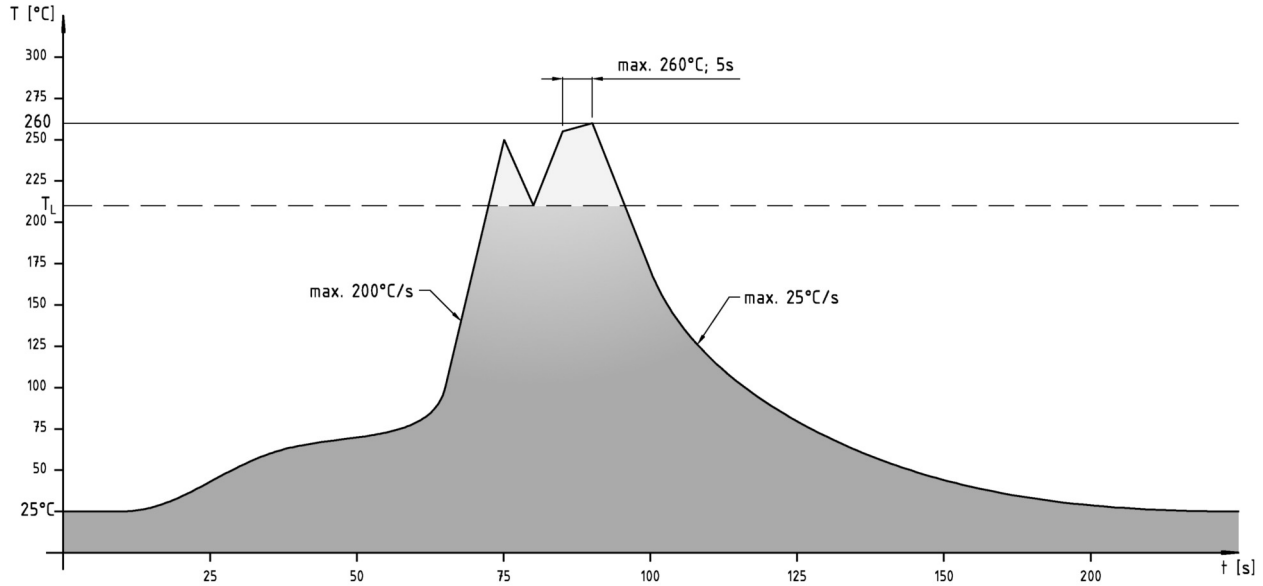
## Wave Soldering Information

### Empfehlungen für das Wellenlötverfahren

#### Recommendations for Wave Soldering

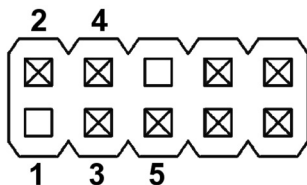
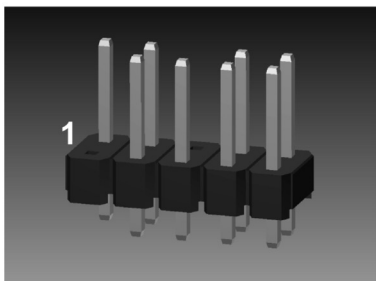
Die Bauteile sollten bei einer Lötbadtemperatur von 260°C in max. 5 Sekunden verlötet werden.

Empfohlenes Wellenlötprofil:



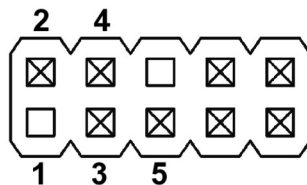
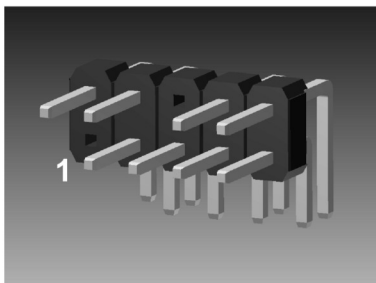
**Gerade Stiftheilen, Sandwich-Stiftheilen**  
1-, 2-, 3-reihig

*Straight Pin Headers, Dual Body Pin Headers*  
Single, Double, Triple Row



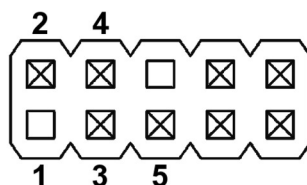
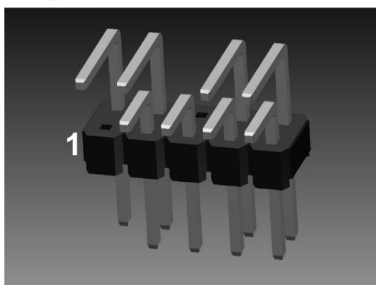
**Gewinkelte Stiftheilen 1-, 2-, 3-reihig**

*Right-angled Pin Headers* Single, Double, Triple Row



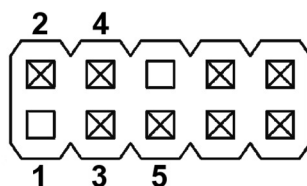
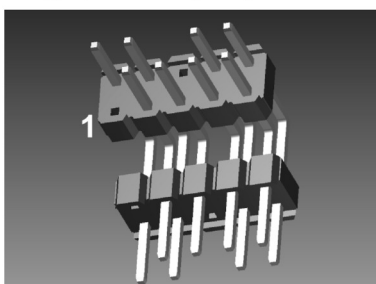
**Steckseitig gewinkelte Stiftheilen 1-, 2-reihig**

*Right-angled Mating Side Pin Headers*  
Single, Double Row



**Gewinkelte Sandwich-Stiftheilen 1-, 2-, 3-reihig**

*Right-angled Dual Body Pin Headers*  
Single, Double, Triple Row



**Serie / Bestellcode**  
Series / Order Code

**Bestückungsschema**  bestückt / assembled  
**Assembly Pattern**  unbestückt / empty